

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

注:本次股东大会还将听取程毅、杨辉、曹智三位独立董事所作的2023年度述职报告。 1、网络投票时间:2024年4月20日。 2、特别决议议案:议案11.01。 3、对中小投资者单独计票的议案:议案4.7, 8, 9, 13, 14, 15。 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9, 10。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their shares.

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、会议登记方法 (一) 登记时间:2024年5月10日9:00至2024年5月13日17:00。

6、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料原件及复印件。 六、其他事项 (一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting results for various resolutions.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票数, 投票人. Lists individual votes for various resolutions.

委托书签(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托日期: 年月日。 附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting results for resolutions 4.00 to 4.06.

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对选举董事、监事人选, 董事候选人有6名; 应选独立董事2名, 独立董事候选人有3名; 应选监事2名, 监事候选人有3名。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Summary of voting results for resolutions 6.00 to 6.03.

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 1、会议召开时间:2024年4月29日(星期一)15:30-16:30。 2、会议召开方式:网络互动方式。 3、上市公司参会人员:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事。

一、说明会类型 (二) 投资者参加方式 1、投资者可通过2024年4月29日(星期一)15:30-16:30通过网站http://esoch.com.cn/ldk08hr16或使用微信扫描下方二维码加入会议。

五、联系人及咨询方式 联系人:证券事务代表王璐 电话:0551-67139968-7099 传真:0551-67139968-7099 邮箱:zhengqun@xinhuicheng.com.cn

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 证券种类, 上市交易所简称, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists securities and their details.

2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要经营模式 1 盈利模式 公司属于集成电路行业的封装测试服务环节,采用行业惯用的OSAT(半导体封装测试外包)模式。

Table with 4 columns: 上游封装, 中间封装, 下游封装, 封装测试. Describes the packaging and testing process flow.

(二) 主要经营模式 1 盈利模式 公司属于集成电路行业的封装测试服务环节,采用行业惯用的OSAT(半导体封装测试外包)模式。



2 采购模式 公司的采购模式为按单采购,由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单,根据需求单向供应商下达采购订单。

3 生产模式 公司采用直接模式进行销售,制定了相应的销售管理制度。作为集成电路封装测试企业,公司完成对客户的技术需求进行工艺验证,验证通过后方能与客户开始合作。

4 销售模式 公司主要采用直接模式进行销售,制定了相应的销售管理制度。作为集成电路封装测试企业,公司完成对客户的技术需求进行工艺验证,验证通过后方能与客户开始合作。

5 研发模式 公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动,夯实已有技术基础,同时进一步拓展技术边界,并持续投入研发资源。

(三) 主要研发情况 1 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

2 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

3 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

4 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

5 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

6 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

7 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

8 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

9 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

亚细亚等亚洲新兴市场区域,中国台湾地区是最早兴起集成电路产业封装测试代工模式的地区,也是目前全球最大的集成电路封装基地。

10 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

11 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

12 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

13 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

14 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

15 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

16 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

17 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

18 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

19 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

20 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

21 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

22 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

23 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

24 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

25 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

26 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

27 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

28 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

29 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

30 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

31 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

32 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

33 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

34 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

35 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

36 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

37 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

38 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。

39 行业发展的阶段及基本特点 半导体行业快速发展的主要特点包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类。